

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2022-136

比亚迪股份有限公司

关于终止分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司

至创业板上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市的议案》，同意终止推进比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）分拆上市事项，同意比亚迪半导体终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。待条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、本次分拆基本情况

2020 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

2021 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市方案的议案》等与本次分拆上市相关的议案，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

2021 年 6 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市方案的议案》等与本次分拆上市相关的议案。

2021 年 6 月 29 日，比亚迪半导体收到深交所发出的《关于受理比亚迪半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审

[2021]283号)。

2021年10月22日，公司取得香港联合交易所有限公司就本次分拆上市的批复及保证配额的豁免同意函。

2022年1月27日，比亚迪半导体的上市申请通过深交所创业板上市委2022年第5次审议会议的审核。

2022年11月15日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

二、本次分拆终止情况

在公司推进比亚迪半导体分拆上市期间，我国新能源汽车行业需求呈爆发式增长。根据中国乘联会数据，2022年1-9月，我国新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%，预计2022年全年新能源汽车销量将达到650万辆。新能源汽车行业的高速增长态势，使得晶圆产能成为车规级功率半导体模块产能瓶颈。

比亚迪半导体为了扩大晶圆产能，在审期间已投资实施济南功率半导体产能建设项目。济南项目目前已成功投产，产能爬坡情况良好，但面对新能源汽车行业的持续增长，新增晶圆产能仍远不能满足下游需求。为尽快提升产能供给能力和自主可控能力，比亚迪半导体拟抢抓时间窗口，开展大规模晶圆产能投资建设。在济南项目基础上，进一步增加大额投资，预计对比亚迪半导体未来资产和业务结构产生较大影响。

公司为加快晶圆产能建设，综合考虑行业发展情况及未来业务战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分谨慎的研究，决定终止推进本次分拆上市，同意比亚迪半导体终止分拆至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。公司将加快相关投资扩产，待相关投资扩产完成后且条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。

三、终止本次分拆对公司的影响

比亚迪半导体紧抓新能源汽车市场增长机遇，继续投资建设晶圆产能，将进一步深化垂直整合，极大程度缓解产能瓶颈，增强车规级半导体的产能供给能力和自主可控能力，有效满足下游新能源汽车行业不断扩张的整体市场需求，进而巩固比亚迪半导体的可持续竞争优势，维持其行业领先地位，提升持续盈利能力。

待公司完成相关投资扩产后且条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。终止本次分拆上市不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，也不会对公司未来发展战略造成重大不利影响。同时，公司承诺在终止所属子公司比亚迪半导体至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件：

- 1、第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2022年11月15日